



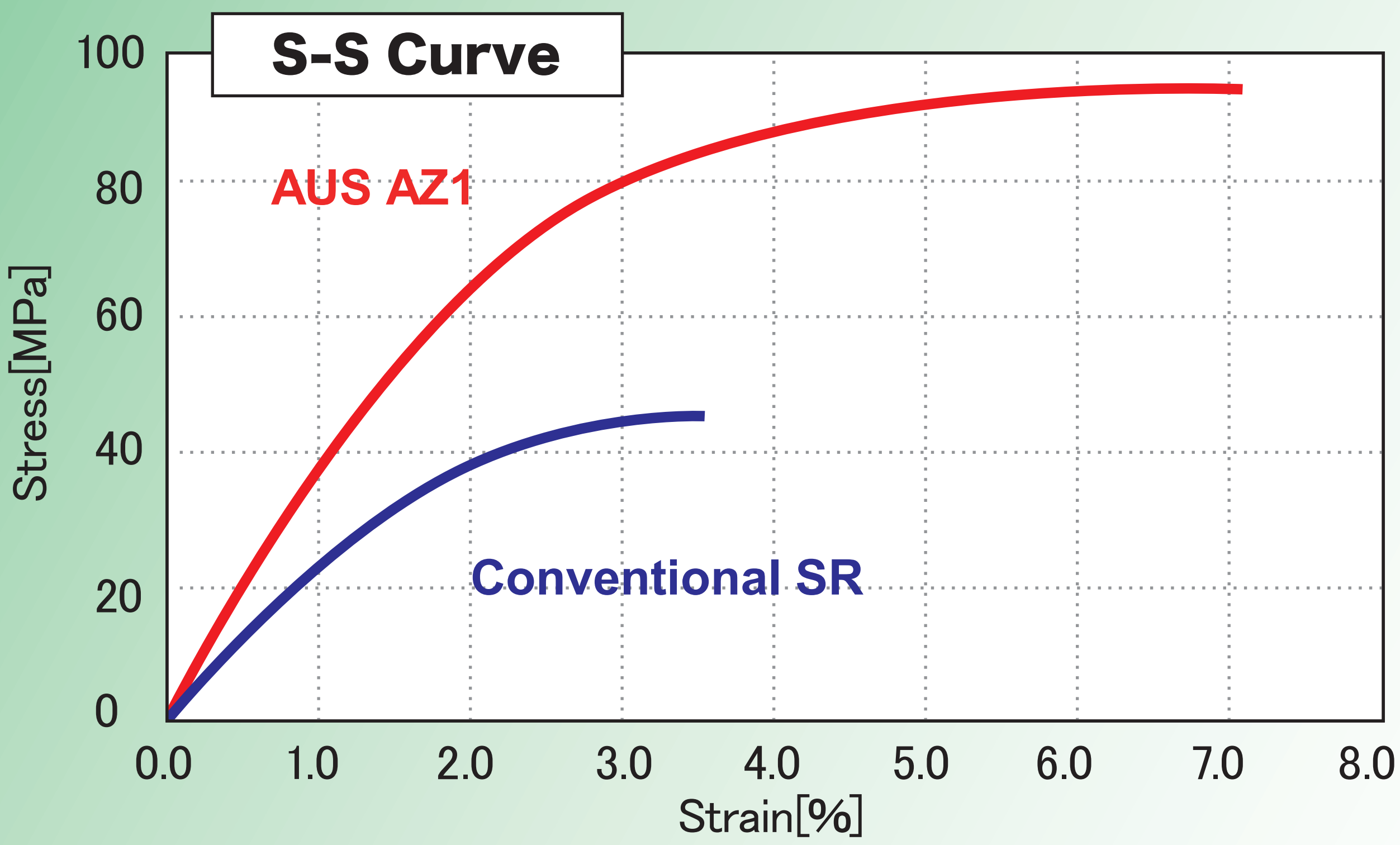
# アルカリ現像型パッケージ用 ソルダーレジスト

Photoimageable Solder Resist for IC Package Substrate Application.

## Liquid Type Solder Resist AUS AZ1 for FC-xGA (Server/ Automotive向けIC Package Substrate対応)

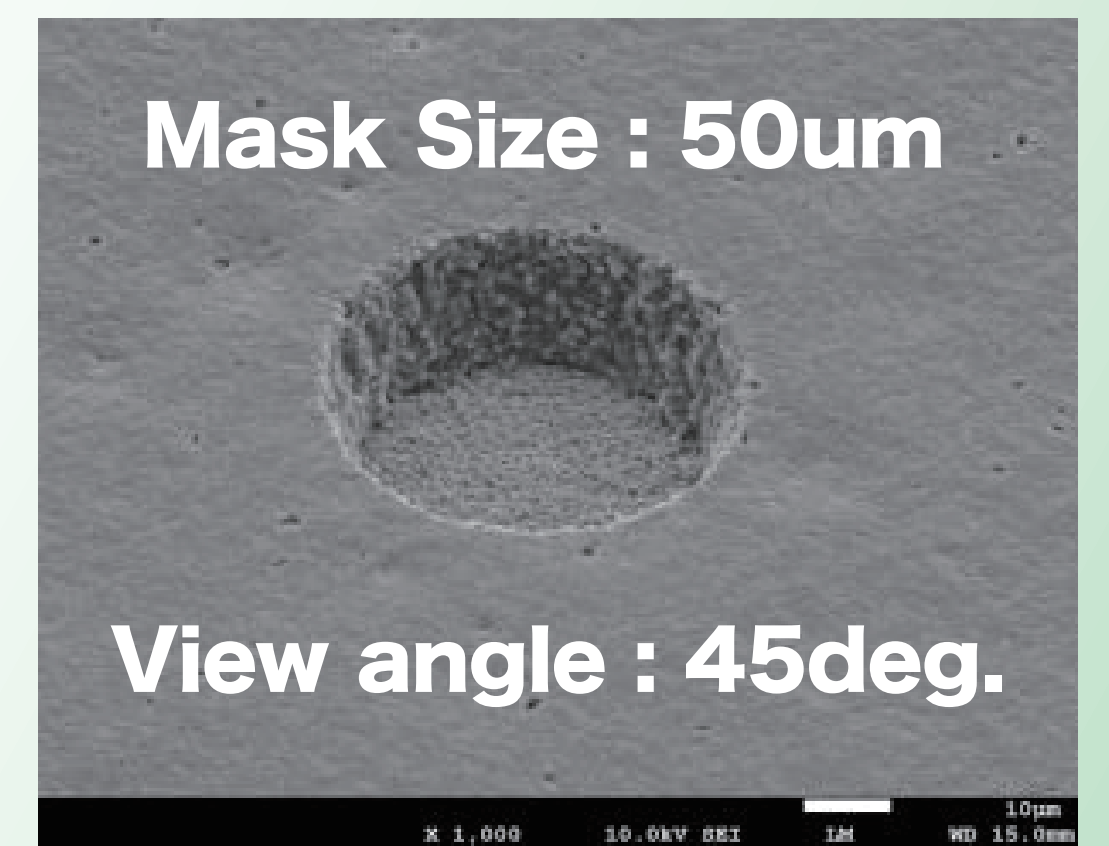
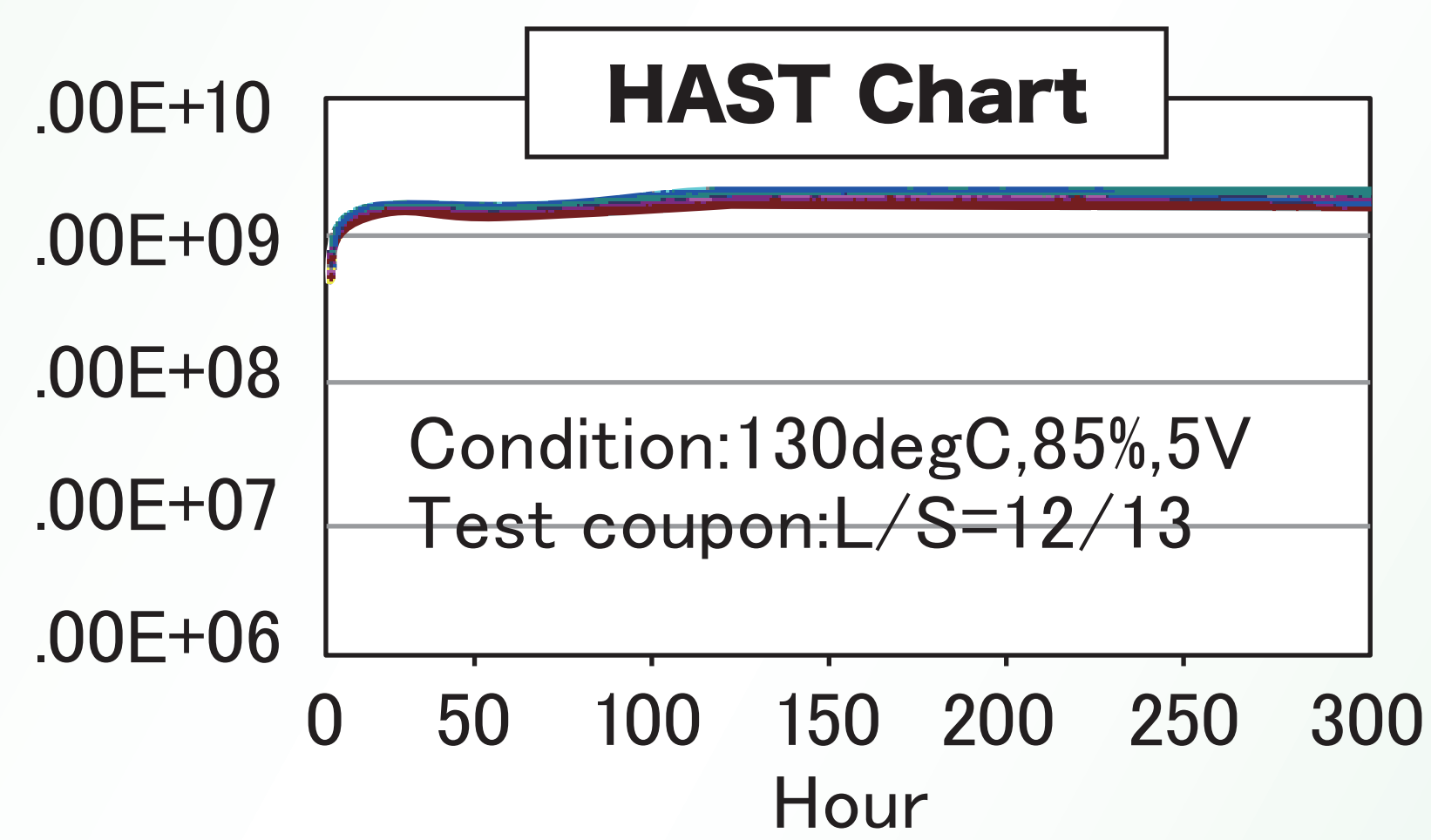
### 特徴 Features

- 高クラック耐性(Excellent TCT resistance)
- 高HAST特性(Excellent HAST resistance)
- 優れた塗膜物性(Excellent Property)
- フィルムタイプ(AUS AZ1-F)もリリース予定



### 特性 Properties

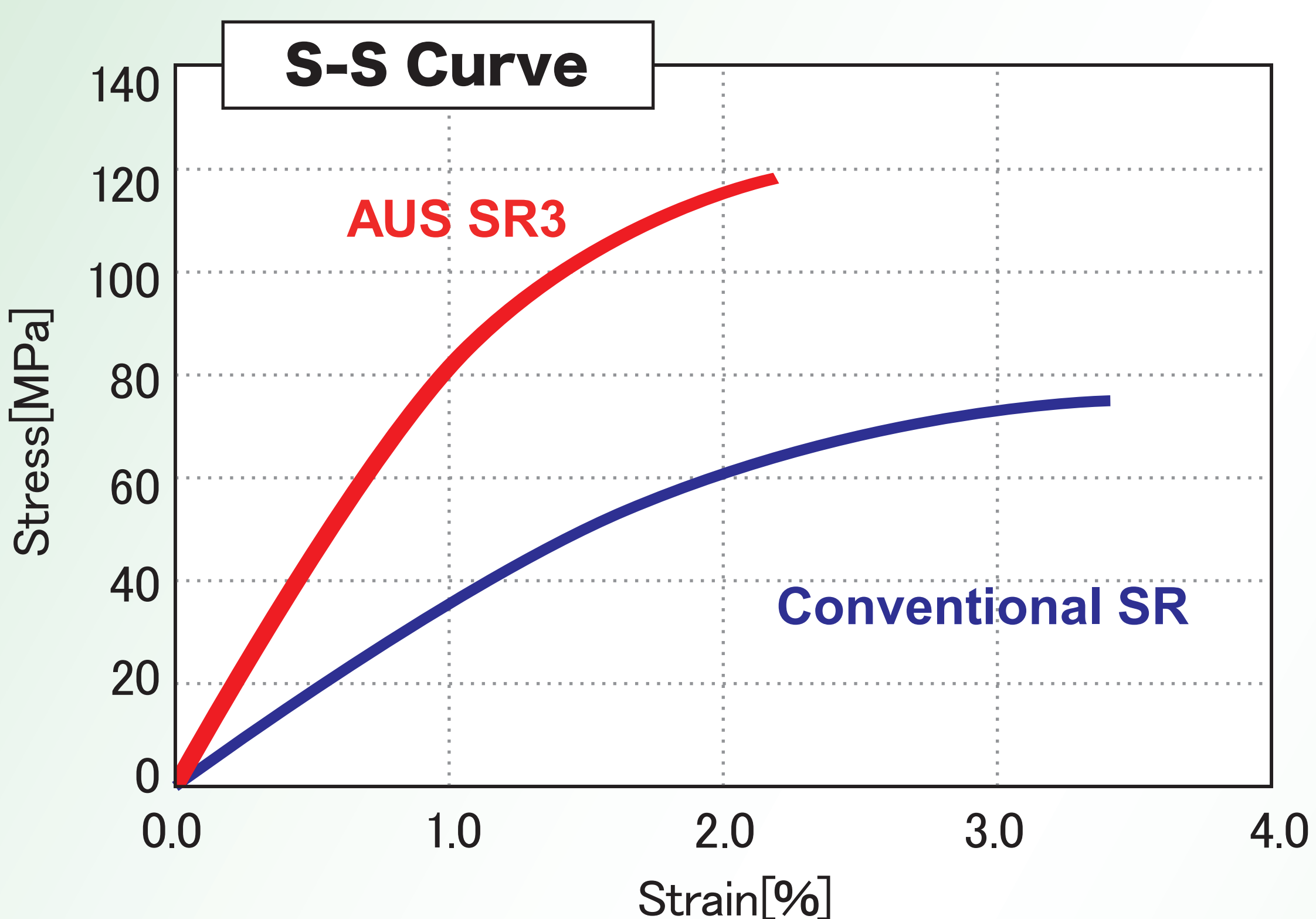
ガラス移転点 Tg *TMA method	150-160 deg.c
線膨張係数 CTE ( $\alpha 1$ )	35-40 ppm
弾性率 Elastic modulus	3.5-4.0 GPa
破壊強度 Tensile strength	90 - 95MPa
破壊伸び率 Elongation	6.0-7.0 %
HAST 耐性 (130deg.c/85%RH, 5V, L/S=12/13)	300h Pass
冷熱サイクル耐性 (150deg.c $\leftrightarrow$ -65deg.c)	1000cycle Pass



## Dry Film Type Solder Resist AUS SR3 for FC-CSP, Memory (極薄コア/コアレス向け IC Package Substrate対応)

### 特徴 Features

- 高弾性率/高強度 (High modulus & strength)
- 高Tg/低CTE (High Tg /Low CTE )
- 優れたHAST耐性 (High HAST Resistance)



### 特性 Properties

ガラス転移点 Tg *TMA method	150-160 deg.c
線膨張係数 CTE ( $\alpha 1$ )	15-20 ppm
弾性率 Elastic modulus	8.5-9.5 GPa
破壊強度 Tensile strength	90 -100MPa
破壊伸び率 Elongation	2.0-3.0 %
HAST 耐性 (130deg.c/85%RH, 5V, L/S=12/13)	300h Pass

